

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











本製品のラインナップは、下記設計を網羅しています:

- •90アングル (水平) および180ストレート (垂直)
- ラッチアップ/ラッチダウン
- •THT、THR、SMDはんだプロセス
- •幅広いデザインタイプ、LED内蔵、シールドタブ付き
- •パフォーマンスカテゴリ3 から Cat. Cat.6。
- •トレイ包装 (TY) またはテープ・オン・リール (RL)
- ANSI / TIA-1096-AおよびIEC 60603に準拠したモジュラーRJ45コネクタに対応
- 絶縁耐力 ≥1500 V AC RMS(2250 V ACピーク値)、IEEE 802.3準拠
- •IEC 60603に準拠した絶縁耐力≥1500 V AC (ピーク値) または≥1500 V DC

#### 特性と長所:

- •最大性能に対応する 40C から + 85C の温度範囲拡張
- •30µ" 金メッキで耐腐食性を強化
- •0.3mm 以上のスタンドオフによる最適なはんだ付け加工

#### 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, RJ45ジャック, Cat. 5e , THT/THRはんだ接続, 90°, ラッチオプション: 下部, LED: はい, 極数: 8, トレイ(手動式アセンブリ)
注文番号	<u>2613200000</u>
種別	RJ45C5E R1D 3.2N4G/Y TY
GTIN (EAN)	4050118623802
数量	600 Stück
パッケージ	トレイ(手動式アセンブリ)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 寸法と重量

深さ	21.27 mm	奥行き (インチ)	0.837 inch
高さ	13.45 mm	高さ(インチ)	0.53 inch
下位バージョンの高さ	13.45 mm	—————————————————————————————————————	15.88 mm
幅(インチ)	0.625 inch	正味重量	1.615 g

## システム仕様

LED	はい	PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続
はんだピン位置の公差	0.1 mm	はんだピン寸法	八角形
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動 はんだ付け, フローはんだ	カテゴリー	
	付け		Cat. 5e
シールド	はい	シールド面	ニッケルメッキ
ソルダーピン長 (I)	3.2 mm	ピッチ (mm) (P)	1.27 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.05 "	プラギング回数	750
	下部	保護度合い	IP20
外向きエルボ	90°	性能カテゴリ	Cat. 5e
接続方式	はんだ接続	極数	8
製品ファミリー	データの最小化 – RJ45モ ジュラージャック		

### 電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3atに適合	定格電圧	125 V	
絶縁耐性	≥ 500 MΩ	 耐電圧、接点 / シールド	1500 V DC	
耐雷圧 接占 / 接占	1000 V DC			

### 材料データ

絶縁材	PA 9T		黒色
カラーチャート(類似)	RAL 9011	 絶縁耐性	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金		ニッケル下地金メッキ
保管温度、最小	-40 °C	 保管温度、最大	85 °C
動作温度、最小	-40 °C	 動作温度、最大	85 °C

#### 梱包

パッケージ	トレイ(手動式アセンブ	VPE 長	
	y)		406 mm
VPE幅	313 mm	VPEの高さ	149 mm

### 分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

### 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

-7	≕刀
푯	祕

ROHS	適合
ダウンロード	
承認/証明書/適合証明書	Certificate of Compliance
カタログ	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

### 製品の利点

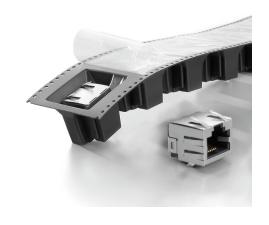


### 製品の利点

## 製品の利点



全はんだプロセスに適合 SMT、THAT、または THR



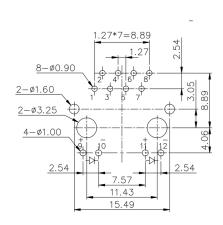


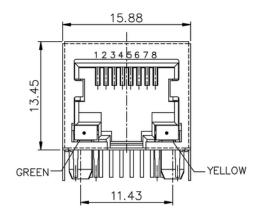
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

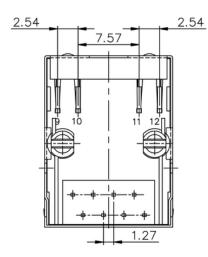
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

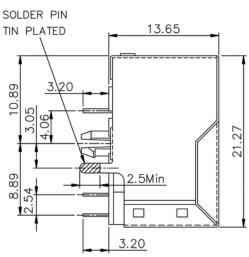
www.weidmueller.com

図面









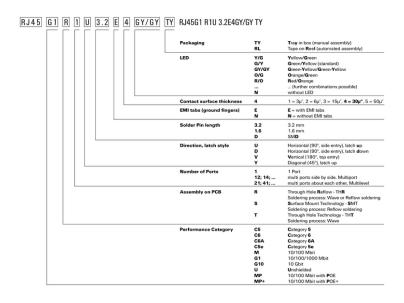


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



凡例



## Recommended wave solderding profiles

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

### Single Wave:



#### **Double Wave:**



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

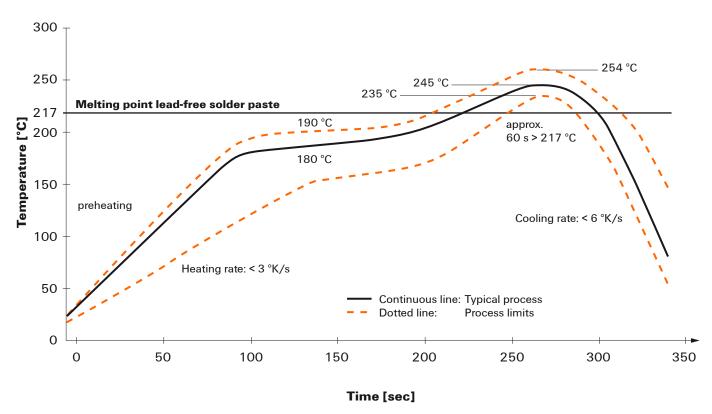


## Recommended reflow soldering profile

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



### **Reflow soldering profile**

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- · Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- · Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3$ K/s. In parallel the solder paste is ,activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq$  -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.